

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<p>(51) Internationale Patentklassifikation 7 : C08L 9/00, 63/00, C09J 163/00</p>	<p>A1</p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 00/37554</b>  (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 29. Juni 2000 (29.06.00)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/09732 (22) Internationales Anmeldedatum: 10. Dezember 1999 (10.12.99) (30) Prioritätsdaten: 198 58 921.2 19. Dezember 1998 (19.12.98) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HENKEL TEROSON GMBH [DE/DE]; Hans-Bunte-Strasse 4, D-69123 Heidelberg (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHENKEL, Hubert [DE/DE]; Robert-Schuman-Strasse 19/1, D-69207 Sand- hausen (DE). (74) Anwalt: MATHES, Nikolaus; Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Patente (VTP), D-40191 Düsseldorf (DE).</p>		<p>(81) Bestimmungsstaaten: AU, BG, BR, BY, CA, CN, CZ, GE, HR, HU, ID, IN, IS, JP, KG, KP, KR, KZ, LK, LT, LV, MD, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, UA, US, UZ, VN, YU, ZA, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.</p>
<p>(54) Title: SHOCK-RESISTANT EPOXIDE RESIN COMPOSITIONS (54) Bezeichnung: SCHLAGFESTE EPOXIDHARZ-ZUSAMMENSETZUNGEN (57) Abstract <p>The invention relates to compositions which are based on a copolymer with at least one glass transition temperature of -30 °C or lower and groups which are reactive with epoxides or a reaction product of said copolymer with a polyepoxide and a reaction product of a polyurethane prepolymer and a polyphenol or aminophenol; at least one epoxide resin and optionally, latent hardeners. Said compositions are suitable for use as structural adhesives with good shock resistance at low temperatures. Adhesive joints formed with these compositions also have a very high shock peel resistance at low temperatures. Consequently, structural adhesive joints of this type can be used for crash resistant structures in vehicle construction.</p><p>(57) Zusammenfassung <p>Zusammensetzungen auf der Basis eines Copolymeren mit mindestens einer Glasübergangstemperatur von -30°C oder niedriger und gegenüber Epoxiden reaktiven Gruppen oder ein Reaktionsprodukt dieses Copolymers mit einem Polyepoxid sowie einem Reaktionsprodukt aus einem Polyurethan-Prepolymer und einem Polyphenol oder Aminophenol sowie mindestens einem Epoxidharz und gegebenenfalls latenten Härtern eignen sich als Strukturklebstoffe mit guter Tieftemperatur-Schlagfestigkeit. Verklebungen mit diesen Zusammensetzungen weisen auch bei tiefen Temperaturen eine sehr hohe Schlagschälarbeit auf, so daß sich derartige Strukturverklebungen für Crash-resistente Strukturen im Fahrzeugbau zu verwenden sind.</p></p></p>		

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

## **"Schlagfeste Epoxidharz-Zusammensetzungen"**

---

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Gemischen aus speziellen Dien-Copolymeren und Phenol-terminierten Polyurethanen oder Polyharnstoffen im Gemisch mit Epoxidharzen und/oder Addukte von Epoxidharzen an Dien-Copolymere und/oder das Polyurethan oder den Polyharnstoff als schlagfeste Epoxidharz-Klebstoffe mit besonders guten Tieftemperatureigenschaften, sowie reaktive, vorzugsweise einkomponentige Schmelzklebstoffe mit guter Tieftemperaturschlagfestigkeit.

Reaktive Schmelzklebstoffe auf Epoxidbasis sind bekannt. Im Maschinen-, Fahrzeug- oder Gerätebau, insbesondere im Flugzeugbau, Schienenfahrzeugbau oder Kraftfahrzeugbau werden die Bauteile aus den verschiedenen metallischen Komponenten und/oder Verbundwerkstoffen in zunehmendem Maße mit Hilfe von Klebstoffen gefügt. Für strukturelle Verklebungen mit hohen Anforderungen an die Festigkeit werden in großem Umfang Epoxidklebstoffe eingesetzt, insbesondere als heißhärtende, einkomponentige Klebstoffe, die häufig auch als reaktive Schmelzklebstoffe formuliert werden. Reaktive Schmelzklebstoffe sind dabei Klebstoffe, die bei Raumtemperatur fest sind und bei Temperaturen bis zu etwa 80 bis 90°C erweichen und sich wie ein thermoplastisches Material verhalten. Erst bei höheren Temperaturen ab etwa 100°C werden die in diesen Schmelzklebstoffen vorhandenen latenten Härter thermisch aktiviert, so daß eine irreversible Aushärtung zu einem Duroplasten erfolgt. Zum Fügen der Bauteile, z. B. in der Fahrzeugindustrie, wird der Klebstoff

zunächst warm auf mindestens eine Substratoberfläche aufgebracht, die zu verbindenden Bauteile werden dann gefügt. Beim Abkühlen erstarrt der Klebstoff dann und schafft durch dieses physikalische Erstarren eine ausreichende Handhabungsfestigkeit, d. h. eine vorläufige Verbindung. Die so miteinander verbundenen Bauteile werden in den verschiedenen Wasch-, Phosphatier- und Tauchlack-Bädern weiter behandelt. Erst anschließend wird der Klebstoff in einem Ofen bei höheren Temperaturen gehärtet.

Konventionelle Klebstoffe und Schmelzklebstoffe auf Basis von Epoxidharzen sind in ausgehärtetem Zustand hart und spröde. Die mit Ihnen erhaltenen Klebungen weisen zwar in aller Regel eine sehr hohe Zugscherfestigkeit auf. Bei schälender, schlagender oder schlagschälender Beanspruchung, insbesondere bei tieferen Temperaturen platzen diese jedoch ab, so daß es bei dieser Beanspruchungsart der Klebefuge leicht zum Bindungsverlust kommt. Es hat daher bereits zahlreiche Vorschläge gegeben, Epoxidharze durch flexible Zusätze so zu modifizieren, daß ihre Sprödigkeit deutlich reduziert wird. Ein gängiges Verfahren beruht auf der Verwendung spezieller Kautschukaddukte an Epoxidharze, die als heterodisperse Phase in der Epoxidharzmatrix eingelagert sind, so daß die Epoxide schlagfester werden, diese Epoxidharz-Zusammensetzungen werden auch als „Toughened“ bezeichnet. Eine gängige, bekannte Modifizierung von Epoxidharzen der vorgenannten Art besteht in der Umsetzung eines Polybutadien-Co-Acrylnitrilcopolymers mit Carboxyl-Endgruppen mit einem Epoxidharz. Dieses Kautschuk-Epoxidaddukt wird dann in einem oder mehreren unterschiedlichen Epoxidharzen eindispersiert. Dabei muß die Reaktion des Epoxidharzes mit dem carboxylgruppenhaltigen Butadien-Acrylnitrilkautschuk so geführt werden, daß es nicht zu einer vorzeitigen

Aushärtung des Adduktes führt. Obwohl derartig modifizierte Epoxidharz-Zusammensetzungen in bezug auf ihre Schlagfestigkeit bereits eine deutliche Verbesserung gegenüber den unmodifizierten Epoxidharzen darstellen, ist ihr Verhalten gegenüber schälenden bzw. schlagschälenden Beanspruchungen immer noch nicht ausreichend.

Aus der EP-A-0 343 676 sind Klebstoffzusammensetzungen bekannt, die aus einem Gemisch von mehreren Epoxidharzen, einem phenolischen Harz sowie einem Polyurethan-Epoxidaddukt zusammengesetzt sind. Das darin enthaltene Polyurethan-Epoxidaddukt besteht aus einem Umsetzungsprodukt von mehreren Polyalkylenglykolhomo- und Copolymeren mit primären und sekundären OH-Gruppen, einem Diisocyanat und mindestens einem Epoxidharz. Es wird angegeben, daß diese Schmelzklebstoffzusammensetzung gegenüber verschiedenen, kommerziellen einkomponentigen Schmelzklebstoffzusammensetzungen in ihrer Scherfestigkeit, Schälfestigkeit und Schlagfestigkeit verbessert sind, über die Klebstoffeigenschaften der ausgehärteten Klebefuge bei tiefen Temperaturen werden keine Angaben gemacht.

Die US-A-5 290 857 beschreibt eine Epoxidharzklebstoffzusammensetzung enthaltend ein Epoxidharz sowie ein pulverförmiges Kern/Schalepolymer und einen wärmeaktivierbaren Härter für das Epoxidharz. Das pulverförmige Kern/Schalepolymer ist zusammengesetzt aus einem Kern enthaltend ein Acrylat- oder Methacrylatpolymer mit einer Glasübergangstemperatur von  $-30^{\circ}\text{C}$  oder niedriger und einer Schale enthaltend ein Acrylat- oder Methacrylatpolymer, das vernetzende Monomereinheiten enthält und dessen Glasübergangstemperatur größer oder gleich  $70^{\circ}\text{C}$  ist, wobei das Ge-

wichtsverhältnis des Kerns zur Schale im Bereich zwischen 10:1 bis 1:4 liegt. Es wird angegeben, daß diese Zusammensetzungen ausgezeichnete Klebstoffeigenschaften wie Schlagfestigkeit, Zugscherfestigkeit und T-Schälfestigkeit haben und außerdem eine gute partielle Gelierbarkeit besitzen. Angaben über die Eigenschaften von Verklebungen mit diesen Klebstoffen bei tiefen Temperaturen werden nicht gemacht.

In analoger Weise beschreibt die US-A-5 686 509 eine adhäsionsverstärkende Zusammensetzung für Epoxidharze bestehend aus pulverförmigen Copolymerteilchen, die ionisch mit einem mono- oder divalenten Metallkation vernetzt sind. Dabei ist der Kernbereich des Kern/Schalepolymers aus einem Dienmonomer und gegebenenfalls vernetzenden Monomereinheiten zusammengesetzt, der eine Glasübergangstemperatur kleiner oder gleich  $-30^{\circ}\text{C}$  hat. Das Schalencopolymer hat eine Glasübergangstemperatur von mindestens  $70^{\circ}\text{C}$  und ist aus Acrylat oder Methacrylatmonomereinheiten und radikalisch polymerisierbare ungesättigte Carbonsäureeinheiten zusammengesetzt. Die Klebstoffzusammensetzung soll dabei auf 100 Teile Epoxidharz 15 bis 60 Gewichtsteile des adhäsionsverstärkenden Copolymerpulvers und 3 bis 30 Gewichtsteile eines hitzeaktivierbaren Härtingsagens haben. Diese Zusammensetzungen werden zur Anwendung als Strukturklebstoffe für Automobilteile empfohlen. Angaben über die Tieftemperatureigenschaften derartiger Verklebungen werden nicht gemacht.

Aus der EP-A-0 308 664 sind Epoxidharz-Zusammensetzungen bekannt, die ein Epoxid-Addukt eines carboxylgruppenhaltigen Copolymeren auf Basis von Butadien-Acrylnitril oder ähnlichen Butadiencopolymeren enthalten sowie ein Umsetzungsprodukt eines in Epoxidharzen löslichen oder dispergierbaren elastomeren Prepolymeren mit endständigen



Isocyanatgruppen mit einem Polyphenol oder Aminophenol sowie nachfolgender Umsetzung dieses Adduktes mit einem Epoxidharz. Weiterhin können diese Zusammensetzungen ein oder mehrere Epoxidharze enthalten. Fernerhin werden zur Härtung für diese Zusammensetzungen aminofunktionelle Härter, Polyaminoamide, Polyphenole, Polycarbonsäuren und ihre Anhydride oder katalytische Härtungsmittel und gegebenenfalls Beschleuniger vorgeschlagen. Es wird angegeben, daß diese Zusammensetzungen sich als Klebstoffe eignen, die je nach konkreter Zusammensetzung hohe Festigkeit, hohe Glasübergangstemperatur, hohe Schälfestigkeit, hohe Schlagzähigkeit oder hohe Reißfortpflanzungsbeständigkeit haben können.

Die EP-A-0 308 664 macht keine Angaben darüber, ob die dort beschriebenen Zusammensetzungen für Klebstoffe mit guter Tieftemperatur-Schlagfestigkeit geeignet sind.

Die EP-A-0 353 190 beschreibt Epoxidharz-Zusammensetzungen enthaltend ein Addukt aus einem Epoxidharz und einem carboxylierten Butadien-Acrylnitrilcopolymeren sowie ein Umsetzungsprodukt eines hydroxyl-, mercapto- oder aminoterminierten Polyalkylenglycols mit einer Phenolcarbonsäure mit nachfolgender Umsetzung der phenolischen Gruppe mit einem Epoxidharz vor. Der EP-A-0 353 190 ist zu entnehmen, daß diese Zusammensetzungen sich zur Herstellung von Klebstoffen, Klebefilmen, Patches, Dichtungsmassen, Lacken oder Matrixharzen eignen. Es werden keine Angaben darüber gemacht, ob die derart hergestellten Klebstoffe gute Tieftemperatur-Schlagfestigkeit aufweisen.

Gemäß der Lehre der EP-A-0 354 498 bzw. EP-A-0 591 307 lassen sich reaktive Schmelzklebstoffzusammensetzungen aus einer Harzkomponente, mindestens einem thermisch aktivierbaren latenten Härter für die Harzkomponente sowie gegebenenfalls Beschleuniger, Füllstoffe, Thixotropierhilfsmittel und weiteren üblichen Zusätzen herstellen, wobei die Harzkomponente durch die Umsetzung von einem bei Raumtemperatur festen Epoxidharz und einem bei Raumtemperatur flüssigen Epoxidharz mit einem oder mehreren linearen oder verzweigten Polyoxypropylen mit Amino-Endgruppen erhältlich sind. Dabei sollen die Epoxidharze in einer solchen Menge, bezogen auf das Amino-terminierte Polyoxypropylen, eingesetzt werden, daß ein Überschuß an Epoxidgruppen bezogen auf die Aminogruppen gewährleistet ist. Diese Klebstoffzusammensetzungen weisen bereits einen hohen Schälwiderstand im Winkelschälversuch auf, der auch bei tiefen Temperaturen erhalten bleibt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, reaktive Klebstoffe der eingangs genannten Art dahingehend weiter zu verbessern, daß sie eine ausreichende Flexibilität aufweisen, eine erhöhte Schälfestigkeit nicht nur bei Raumtemperatur sondern insbesondere auch bei tiefen Temperaturen (unter 0°C) aufweisen. Insbesondere soll die Schälfestigkeit bei tiefen Temperaturen und schlagartiger Belastung einen möglichst hohen Wert aufweisen, damit strukturell geklebte Bauteile auch im Falle eines Unfalls (Crash-Verhalten) den modernen Sicherheitsanforderungen im Fahrzeugbau entsprechen. Dabei sollen diese Verbesserungen ohne Beeinträchtigung der Schälfestigkeit bei hohen Temperaturen sowie der Zugscherfestigkeit erzielt werden. Die reaktiven Klebstoffe müssen darüber hinaus unmittelbar nach der Applikation und vor dem endgültigen Aushärten eine ausreichende Auswaschbeständigkeit haben. Dazu müssen



die Klebstoff-Zusammensetzungen als Schmelzklebstoff, als hochviskoser, warm zu verarbeitender Klebstoff formulierbar sein. Eine andere Möglichkeit ist die Formulierung als Klebstoff, der durch eine thermische Vorreaktion im sogenannten „Rohbau-Ofen“ oder durch Induktionsheizung der Fügeteile geliert werden kann.

Die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe ist den Ansprüchen zu entnehmen. Sie besteht im wesentlichen in der Verwendung von Zusammensetzungen, die

- A) ein Copolymeres mit mindestens einer Glasübergangstemperatur von  $-30^{\circ}\text{C}$  oder niedriger und gegenüber Epoxiden reaktiven Gruppen sowie
  - B) ein Reaktionsprodukt aus einem Polyurethan-Prepolymer und einem Polyphenol oder Aminophenol sowie
  - C) mindestens ein Epoxidharz enthalten
- als Strukturklebstoffe mit guter Tieftemperatur-Schlagfestigkeit.

Ein Strukturklebstoff im Sinne dieser Erfindung ist dabei ein Klebstoff, der bei einer Stahlverklebung mindestens eine Zugscherfestigkeit von 15 MPa bei Raumtemperatur besitzt und bei einer erhöhten Temperatur von  $90^{\circ}\text{C}$  immer noch eine Zugscherfestigkeit einer Stahlverklebung von mehr als 10 MPa gewährleistet. Eine gute Tieftemperatur-Schlagfestigkeit eines derartigen Klebstoffes ist dann gegeben, wenn die Schlagschälarbeit bei 2 m/sec nach ISO 11343 bei  $-20^{\circ}\text{C}$  mindestens bei 5 J liegt.

Dabei können die Komponenten A), B) und C) jeweils auch Gemische von Verbindungen der angegebenen Art sein. Vorzugsweise werden die Komponenten A) und B) in separaten Reaktionen mit einem großen stöchiometrischen Überschuß an Epoxidharzen umgesetzt und anschließend ggf. mit

weiteren Epoxidharzen, thermisch aktivierbaren Härtern und/oder weiteren Zusätzen gemischt.

Beispiele für die Copolymeren der Aufbaukomponente A) sind 1,3-Dienpolymere mit Carboxylgruppen und weiteren polaren ethylenisch ungesättigten Comonomeren. Als Dien kann dabei Butadien, Isopren oder Chloropren eingesetzt werden, bevorzugt ist Butadien. Beispiele für polare, ethylenisch ungesättigte Comonomere sind Acrylsäure, Methacrylsäure, niedere Alkylester der Acryl- oder Methacrylsäure, beispielsweise deren Methyl- oder Ethylester, Amide der Acryl- oder Methacrylsäure, Fumarsäure, Itakonsäure, Maleinsäure oder deren niedrere Alkylester oder Halbester, oder Maleinsäure- oder Itakonsäureanhydrid, Vinylester wie beispielsweise Vinylacetat oder insbesondere Acrylnitril oder Methacrylnitril. Ganz besonders bevorzugte Copolymere A) sind Carboxylterminierte Butadienacrylnitrilcopolymere (CTBN), die in flüssiger Form unter dem Handelsnamen Hycar von der Firma B. F. Goodrich angeboten werden. Diese haben Molekulargewichte zwischen 2000 und 5000 und Acrylnitrilgehalte zwischen 10 % und 30 %. Konkrete Beispiele sind Hycar CTBN 1300 X 8, 1300 X 13 oder 1300 X 15.

Weiterhin können als Aufbaukomponente A) auch die aus der US-A-5 290 857 bzw. aus der US-A-5 686 509 bekannten Kern/Schale-Polymeren eingesetzt werden. Dabei sollen die Kernmonomeren eine Glasübergangstemperatur von kleiner oder gleich  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  haben, diese Monomeren können ausgewählt werden aus der Gruppe der vorgenannten Dienmonomeren oder geeigneten Acrylat- oder Methacrylatmonomeren, ggf. kann das Kernpolymer in geringer Menge vernetzende Comonomereinheiten enthalten. Die Schale ist dabei aus Copolymeren aufgebaut, die eine

Glasübergangstemperatur von mindestens 60 °C hat. Die Schale ist vorzugsweise aus niederen Alkylacrylat oder Methacrylat-Monomereinheiten (Methyl- bzw. Ethylester) sowie polaren Monomeren wie (Meth)acrylnitril, (Meth)acrylamid, Styrol oder radikalisch polymerisierbaren ungesättigten Carbonsäuren oder Carbonsäureanhydriden.

Besonders bevorzugt für die Aufbaukomponente A) sind jedoch die Addukte aus Epoxidharzen und den vorgenannten flüssigen CTBN-Kautschuken.

Die Komponente B) kann durch die nachfolgende Formel I dargestellt werden,



Dabei bedeuten

m = 1 oder 2,

n = 2 oder 3,

R<sup>1</sup> ein Rest eines Polyalkylenglykols nach dem Entfernen der funktionellen Gruppen (Hydroxyl- oder Amino-Gruppen),

R<sup>2</sup> = C<sub>6</sub>- bis C<sub>14</sub>-Alkyl, Aryl, Aralkyl (Rest eines Diisocyanates nach Entfernen der Isocyanatgruppen),

X, Y = -O-, -S- oder -NR<sup>4</sup>-, wobei R<sup>4</sup> = H oder C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl,

R<sup>3</sup> = ein carbocyclisch-aromatischer oder araliphatischer m + 1 wertiger Rest mit direkt an den aromatischen Ring gebundenen Gruppen Z und Z = -OH oder -NHR<sup>4</sup> (Rest eines Polyphenols oder Aminophenols nach Entfernen der funktionellen Gruppen).

Dabei ist die Komponente B) ein Reaktionsprodukt aus einem Di- oder Polyamin oder Di- oder Polyol und einem Diisocyanat. Das stöchiometrische Verhältnis zwischen Aminogruppen oder Hydroxylgruppen und Isocyanatgruppen wird dabei so gewählt, daß die Isocyanatgruppen im stöchiometrischen Überschuß sind, vorzugsweise beträgt dieser stöchiometrische Überschuß 1,5 bis 2 gegenüber den Aminogruppen oder Hydroxylgruppen. Das so entstandene Isocyanat-terminierte Polyurethan-Prepolymer wird dann mit einem Überschuß an Polyphenol oder Aminophenol so umgesetzt, daß das Reaktionsprodukt phenolische oder Amino-Endgruppen trägt. In dieses Reaktionsgemisch können zusätzlich noch Polyesterpolyole eingemischt werden. Das so entstandene Reaktionsgemisch wird in der Regel direkt mit den weiteren Zusammensetzungs-Bestandteilen wie der Komponente A) und weiteren Epoxyharzen vermischt, die Reaktionsmischung kann jedoch auch mit einem großen stöchiometrischen Überschuß an Epoxidharzen so umgesetzt werden, daß ein Adduktionsprodukt mit terminalen Epoxidgruppen entsteht.

Für die Addition der Polyphenole oder Aminophenole können im Prinzip eine Vielzahl von Polyurethanprepolymeren verwendet werden, bevorzugt werden jedoch solche, die aus hydroxyterminierten oder aminotermierten Polyalkylenglykolen, insbesondere di- oder trifunktionelle hydroxyterminierte oder aminotermierte Polypropylenglykole, Polyethylenglykole oder Copolymere von Propylenglykol und Ethylenglykol sowie insbesondere auch Polytetramethylenglykole (Poly-THF). Außerdem sind auch aminotermierte oder hydroxyterminierte Polybutadiene als Aufbaukomponenten für die Polyurethanprepolymere geeignet. Die hydroxy- oder aminotermierten Polyalkylenglykole sowie die

entsprechenden Polybutadien-Derivate haben Molekulargewichte zwischen 400 und 5000.

Als Di- oder Polyisocyanate zur Herstellung der Polyurethanprepolymere eignen sich prinzipiell alle in der Polyurethanchemie bekannten aromatischen, aliphatischen oder cycloaliphatischen Polyisocyanate.

Beispiele für geeignete aromatische Polyisocyanate sind: Alle Isomeren des Toluylendiisocyanats (TDI) entweder in isomerenreiner Form oder als Mischung mehrerer Isomere, Naphthalin-1,5-Diisocyanat, Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI), Diphenylmethan-2,4'-Diisocyanat sowie Mischungen des 4,4'-Diphenylmethandiisocyanats mit dem 2,4'-Isomeren oder deren Mischungen mit höherfunktionellen Oligomeren (sogenanntes Roh-MDI). Beispiele für geeignete cycloaliphatische Polyisocyanate sind die Hydrierungsprodukte der vorgenannten aromatischen Diisocyanate wie z.B. das 4,4'-Dicyclohexylmethandiisocyanat ( $H_{12}$ MDI), 1-Isocyanatomethyl-3-Isocyanato-1,5,5-Trimethyl-cyclohexan (Isophoron-Diisocyanat, IPDI), Cyclohexan-1,4-Diisocyanat, hydriertes Xylylen-Diisocyanat ( $H_6$ XDI), m- oder p-Tetramethylxylylendiisocyanat (m-TMXDI, p-TMXDI) und Dimerfettsäure-Diisocyanat. Beispiele für aliphatische Polyisocyanate sind Hexan-1,6-Diisocyanat (HDI), 1,6-Diisocyanato-2,2,4-Trimethylhexan, 1,6-Diisocyanato-2,4,4-Trimethylhexan, Butan-1,4-Diisocyanat sowie 1,12-Dodecandiisocyanat ( $C_{12}$ DI). Besonders bevorzugt sind dabei die aliphatischen, cycloaliphatischen oder auch araliphatische Diisocyanate.

Die für das Reaktionsprodukt B) einzusetzenden Polyphenole oder Amino-phenole sind entweder aromatische Di- oder Trihydroxyverbindungen, die

sich von einem ein- oder mehrkernigen carbocyclisch-aromatischen Rest ableiten oder es sind die entsprechenden Amino-hydroxyverbindungen. Dabei können die aromatischen Ringe entweder kondensiert oder über Brückenglieder oder über eine kovalente Bindung miteinander verknüpft sein.

Beispiele für die erstgenannten Verbindungen sind Hydrochinon, Resorcin, Brenzkatechin, Isomere des Dihydroxynaphthalins (Isomeren-rein oder Mischung mehrerer Isomere) Isomere des Dihydroxyanthracens sowie die entsprechenden Amino-hydroxy-verbindungen. Die Polyphenole oder Aminophenole, die sich von carbocyclisch-aromatischen Verbindungen herleiten, deren aromatische Kerne über Brückenglieder verknüpft sind lassen sich durch die allgemeine Formel II darstellen:



worin Z die oben definierte Bedeutung hat,

AR steht für einen einkernigen aromatischen Rest, der ggf. durch Alkyl oder Alkenylreste weiter substituiert sein kann.

B steht für das Brückenglied, dieses kann ausgewählt werden aus der Gruppe bestehend aus einer covalenten Bindung,  $-\text{CR}^5\text{R}^6-$ ,  $-\text{O}-$ ,  $-\text{S}-$ ,  $-\text{SO}_2-$ ,  $-\text{CO}-$ ,  $-\text{COO}-$ ,  $-\text{CONR}^7-$  und  $\text{SiR}^8\text{R}^9-$ . Dabei bedeuten  $\text{R}^5$ ,  $\text{R}^6$  und  $\text{R}^7$  unabhängig voneinander Wasserstoff,  $-\text{CF}_3$  oder  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$  Alkyl oder  $\text{R}^5$  und  $\text{R}^6$  bilden zusammen mit dem gemeinsamen C-Atom einen cycloaliphatischen Rest mit 5 bis 7 Ring C-Atomen,  $\text{R}^8$  und  $\text{R}^9$  bedeuten  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$ -Alkyl. Dabei können die beiden Gruppierungen B und Z in der Formel II unabhängig voneinander in ortho-, meta- oder para-Stellung angeordnet sein. Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel II sind 4,4'-Dihydroxydiphenyl oder die Bisphenole A und/oder F.



Die in der Komponente B) gegebenenfalls enthaltenen Polyesterpolyole sind an sich bekannte Polyesterpolyole, wie sie in der Polyurethanchemie z. B. zur Herstellung von Schmelzklebstoffen verwendet werden.

Beispiele für derartige Polyesterpolyole sind Umsetzungsprodukte von Dicarbonsäuren, wie Glutarsäure, Adipinsäure, Sebazinsäure, Korksäure, 3,3-Dimethyl-Glutarsäure, Terephthalsäure, Isophthalsäure Dimerfettsäure mit niedermolekularen difunktionellen Alkoholen wie z.B. Ethylenglykol, Propylenglykol, 1,4-Butandiol, Diethylenglykol, Triethylenglykol oder Dimerfettalkohol. Ggf. können die geeigneten Polyesterpolyole auch leicht verzweigt sein, d.h. zu ihrer Herstellung wurden untergeordnete Mengen einer Tricarbonsäure bzw. eines trifunktionellen Alkohols verwendet.

Als Epoxidharze für die Komponente C) bzw. für die Epoxid-Adduktbildung bzw. zur Abmischung der Komponenten A) und B) eignen sich eine Vielzahl von Polyepoxiden, die mindestens 2 1,2-Epoxigruppen pro Molekül haben. Das Epoxid-Äquivalent dieser Polyepoxide kann zwischen 150 und 4000 variieren. Die Polyepoxide können grundsätzlich gesättigte, ungesättigte, cyclische oder acyclische, aliphatische, alicyclische, aromatische oder heterocyclische Polyepoxidverbindungen sein. Beispiele für geeignete Polyepoxide schließen die Polyglycidylether ein, die durch Reaktion von Epichlorhydrin oder Epibromhydrin mit einem Polyphenol in Gegenwart von Alkali hergestellt werden. Hierfür geeignete Polyphenole sind beispielsweise Resorcin, Brenzkatechin, Hydrochinon, Bisphenol A (Bis-(4-Hydroxy-phenyl)-2,2-propan)), Bisphenol F (Bis(4-hydroxyphenyl)methan), Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1-isobutan, 4,4'-

Dihydroxybenzophenon, Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1-ethan, 1,5-Hydroxynaphthalin.

Weitere prinzipiell geeignete Polyepoxide sind die Polyglycidylether von Polyalkoholen oder Diaminen. Diese Polyglycidylether leiten sich von Polyalkoholen wie Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, 1,2-Propylenglykol, 1,4-Butylenglykol, Triethylenglykol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol oder Trimethylolpropan ab.

Weitere Polyepoxide sind Polyglycidylester von Polycarbonsäuren, beispielsweise Umsetzungen von Glycidol oder Epichlorhydrin mit aliphatischen oder aromatischen Polycarbonsäuren wie Oxalsäure, Bernsteinsäure, Glutarsäure, Terephthalsäure oder Dimerfettsäure.

Weitere Epoxide leiten sich von den Epoxidierungsprodukten olefinisch ungesättigter cycloaliphatischer Verbindungen oder von nativen Ölen und Fetten ab.

Ganz besonders bevorzugt werden die Epoxidharze, die sich durch Reaktion von Bisphenol A oder Bisphenol F und Epichlorhydrin ableiten. Dabei werden in der Regel Mischungen aus flüssigen und festen Epoxidharzen eingesetzt, wobei die flüssigen Epoxidharze vorzugsweise auf der Basis des Bisphenols A sind und ein hinreichend niedriges Molekulargewicht aufweisen. Insbesondere für die Adduktbildung der Komponenten A) und B) werden bei Raumtemperatur flüssige Epoxidharze eingesetzt, die in der Regel ein Epoxid-Äquivalentgewicht von 150 bis etwa 220 haben, besonders bevorzugt ist ein Epoxi-Äquivalentgewichtsbereich von 182 bis 192.

Die Härte des reaktiven Klebstoffes im erkalteten Zustand, d. h. insbesondere nach dem Auftragen auf das zu fügende Substrat, aber vor der Aushärtung, hängt vom Kondensationsgrad und damit Molekulargewicht insbesondere der Komponente B) ab sowie vom Verhältnis von festem Epoxidharz zu flüssigem Epoxidharz. Je höher der Kondensationsgrad (und damit das Molekulargewicht) des Kondensationsproduktes B) ist und je größer der Anteil an festem Epoxidharz in der Zusammensetzung ist, um so härter ist der erkaltete, semikristalline Klebstoff.

Als thermisch aktivierbare oder latente Härter für das Epoxidharz-Bindemittelsystem aus den Komponenten A), B) und C) können Guanidine, substituierte Guanidine, substituierte Harnstoffe, Melaminharze, Guanamin-Derivate, cyclische tertiäre Amine, aromatische Amine und/oder deren Mischungen eingesetzt werden. Dabei können die Härter sowohl stöchiometrisch mit in die Härtingsreaktion einbezogen sein, sie können jedoch auch katalytisch wirksam sein. Beispiele für substituierte Guanidine sind Methylguanidin, Dimethylguanidin, Trimethylguanidin, Tetramethylguanidin, Methylisobiguanidin, Dimethylisobiguanidin, Tetramethylisobiguanidin, Hexamethylisobiguanidin, Hepamethylisobiguanidin und ganz besonders Cyanuguanidin (Dicyandiamid). Als Vertreter für geeignete Guanamin-Derivate sein alkylierte Benzoguanamin-Harze, Benzoguanamin-Harze oder Methoximethylethoxymethylbenzoguanamin genannt. Für die einkomponenten, hitzehärtenden Schmelzklebstoffe ist selbstverständlich das Auswahlkriterium die niedrige Löslichkeit dieser Stoffe bei Raumtemperatur in dem Harzsystem, so daß hier feste, feinvermahlene Härter den Vorzug haben, insbesondere

ist Dicyandiamid geeignet. Damit ist eine gute Lagerstabilität der Zusammensetzung gewährleistet.

Zusätzlich oder anstelle von den vorgenannten Härtern können katalytisch wirksame substituierte Harnstoffe eingesetzt werden. Dies sind insbesondere der p-Chlorphenyl-N,N-dimethylharnstoff (Monuron), 3-Phenyl-1,1-dimethylharnstoff (Fenuron) oder 3,4-Dichlorphenyl-N,N-dimethylharnstoff (Diuron). Prinzipiell können auch katalytisch wirksame tertiäre Acryl- oder Alkyl-Amine, wie beispielsweise das Benzyldimethylamin, Tris(dimethylamino)phenol, Piperidin oder Piperidinderivate eingesetzt werden, diese haben jedoch vielfach eine zu hohe Löslichkeit in dem Klebstoffsystem, so daß hier keine brauchbare Lagerstabilität des einkomponentigen Systems erreicht wird. Weiterhin können diverse, vorzugsweise feste Imidazolderivate als katalytisch wirksame Beschleuniger eingesetzt werden. Stellvertretend genannt seien 2-Ethyl-2-methylimidazol, N-Butylimidazol, Benzimidazol sowie N-C<sub>1</sub> bis C<sub>12</sub>-Alkylimidazole oder N-Arylimidazole.

In der Regel enthalten die erfindungsgemäßen Klebstoffe weiterhin an sich bekannte Füllstoffe wie zum Beispiel die diversen gemahlenen oder gefällten Kreiden, Ruß, Calcium-Magnesiumcarbonate, Schwerspat sowie insbesondere silicatische Füllstoffe vom Typ des Aluminium-Magnesium-Calcium-Silicats, z. B. Wollastonit, Chlorit.

Weiterhin können die erfindungsgemäßen Klebstoffzusammensetzungen gängige weitere Hilfs- und Zusatzmittel wie z. B. Weichmacher, Reaktivverdünner, Rheologie-Hilfsmittel, Netzmittel, Alterungsschutzmittel, Stabilisatoren und/oder Farbpigmente enthalten.

Die erfindungsgemäßen Klebstoffe lassen sich einerseits als einkomponentige Klebstoffe formulieren, wobei diese sowohl als hochviskose warm applizierbare Klebstoffe formuliert werden können als auch als thermisch härtbare Schmelzklebstoffe. Weiterhin können diese Klebstoffe als einkomponentige vorgeliebte Klebstoffe formuliert werden, im letztgenannten Fall enthalten die Zusammensetzungen entweder feinteilige thermoplastische Pulver wie z. B. Polymethacrylate, Polyvinylbutyral oder andere thermoplastische (Co)polymere oder das Härtungssystem ist so abgestimmt, daß ein zweistufiger Härtungsprozeß stattfindet, wobei der Gelierungsschritt nur eine teilweise Aushärtung des Klebstoffes bewirkt und die Endaushärtung im Fahrzeugbau z. B. in einem der Lackieröfen, vorzugsweise der KTL-Ofen, stattfindet.

Die erfindungsgemäßen Klebstoffzusammensetzungen können auch als zweikomponentige Epoxy-Klebstoffe formuliert werden, bei denen die beiden Reaktionskomponenten erst kurz vor der Applikation miteinander vermischt werden, wobei die Aushärtung dann bei Raumtemperatur oder mäßig erhöhter Temperatur stattfindet. Als zweite Reaktionskomponente können hierbei die für zweikomponentige Epoxy-Klebstoffe an sich bekannten Reaktionskomponenten eingesetzt werden können, beispielsweise Di- oder Polyamine, aminoterminalisierte Polyalkylenglykole (z. B. Jeffamine, Amino-Poly-THF) oder Polyaminoamide. Weitere Reaktivpartner können mercaptofunktionelle Prepolymere sein wie z. B. die flüssigen Thiokol-Polymere. Grundsätzlich können die erfindungsgemäßen Epoxyzusammensetzungen auch mit Carbonsäureanhydriden als zweiter Reaktionskomponente in zweikomponentigen Klebstoffformulierungen ausgehärtet werden.

Neben den eingangs erwähnten Anwendungen können die erfindungsgemäßen Klebstoffzusammensetzungen auch als Vergußmassen in der Elektro- oder Elektronikindustrie, als Die-Attach-Klebstoff in der Elektronik zum Verkleben von Bauteilen auf Leiterplatten eingesetzt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind Matrix-Materialien für Verbundwerkstoffe wie z. B. faserverstärkte Verbundwerkstoffe.

Ein ganz besonders bevorzugtes Anwendungsfeld der erfindungsgemäßen Klebstoffe sind jedoch strukturelle Verklebungen im Fahrzeugbau.

Je nach Anforderungsprofil an den Klebstoff in bezug auf seine Verarbeitungseigenschaften, die Flexibilität, Schlagschälfestigkeit oder Zugfestigkeit können die Mengenverhältnisse der Einzelkomponenten in verhältnismäßig weiten Grenzen variieren. Typische Bereiche für die wesentlichen Komponenten sind:

- Komponente A): 5-25 Gew.-%, vorzugsweise 6-20 Gew.-%
- Komponente B): 5-30 Gew.-%, vorzugsweise 5-20 Gew.-%
- Komponente C): 10-60 Gew.-%, vorzugsweise 15-50 Gew.-%, wobei sich diese Komponente aus einem oder mehreren flüssigen und/oder festen Epoxidharzen zusammensetzt, wobei sie gegebenenfalls auch niedermolekulare Epoxide als Reaktivverdünner enthalten kann,
- Füllstoffe: 10-40 Gew.-%,
- Härterkomponente (für thermisch härtbare Einkomponentensysteme): 1-10 Gew.-%, vorzugsweise 3-8 Gew.-%,
- Beschleuniger: 0,01 bis 3 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 0,8 Gew.-%,
- Rheologie-Hilfsmittel (Thixotropiermittel): 0,5-5 Gew.-%.



Wie bereits eingangs erwähnt, steigen die Anforderungen an moderne Strukturklebstoffe im Fahrzeugbau ständig weiter an, da immer mehr Bauelemente auch tragender Natur durch Klebverfahren gefügt werden. Wie bereits in dem Aufsatz von G. Kötting und S. Singh, „Anforderungen an Klebstoffe für Strukturverbindungen im Karosseriebau“, Adhesion 1988, Heft 9, Seite 19 bis 26 ausgeführt, müssen die Klebstoffe zum einen praxisrelevante Aspekte der Fertigung erfüllen, hierzu gehören automatisierbare Verarbeitung in kurzen Taktzeiten, Haftung auf geölten Blechen, Haftung auf verschiedenen Blechsarten sowie Kompatibilität mit den Prozeßbedingungen der Lackierstraße (Beständigkeit gegen Wasch- und Phosphatierbäder, härtbar während des Einbrennens der KTL-Grundierung, Beständigkeit gegenüber den nachfolgenden Lackier- und Trocknungsoperationen). Darüber hinaus müssen moderne Strukturklebstoffe auch im ausgehärteten Zustand steigende Festigkeits- und Verformungseigenschaften erfüllen. Hierzu gehören die hohe Korrosions- oder Biegesteifigkeit der strukturellen Bauteile sowie die Verformbarkeit bei mechanischer Belastung der Verklebung. Eine möglichst hohe Verformbarkeit der Bauteile gewährleistet einen erheblichen Sicherheitsvorteil bei stoßartiger Belastung (Crash-Verhalten) bei einem Unfall. Dieses Verhalten läßt sich am besten durch die Ermittlung der Schlagarbeit für ausgehärtete Verklebungen ermitteln, hierbei sind sowohl bei hohen Temperaturen bis +90 °C als auch insbesondere bei tiefen Temperaturen bis zu -40 °C ausreichend hohe Werte für die Schlagarbeit bzw. Schlagschälarbeit wünschenswert bzw. erforderlich. Dabei soll zusätzlich eine möglichst hohe Zugscherfestigkeit erzielt werden. Beide Festigkeiten müssen auf einer Vielzahl von Substraten, hauptsächlich geölten Blechen, wie z. B. Karosseriestahlblech, nach den

verschiedensten Methoden verzinktes Stahlblech, Blechen aus diversen Aluminiumlegierungen oder auch Magnesiumlegierungen sowie mit organischen Beschichtungen vom Typ „Bonazinc“ oder „Granocoat“ im Coil-Coating-Verfahren-beschichteten Stahlbleche erzielt werden. Wie in den nachfolgenden Beispielen gezeigt werden wird, erfüllen die erfindungsgemäßen Klebstoffzusammensetzungen diese Anforderungen überraschender Weise in einem sehr hohen Ausmaß.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern. Bei den Zusammensetzungen sind dabei alle Mengenangaben Gewichtsteile wenn nicht anders angegeben.

#### Allgemeine Herstellung für die Komponente A)

Unter Stickstoffatmosphäre und Rühren wurden bei 140 °C ein Carboxy-terminiertes Poly(butadien-co-acrylnitril) (Hycar CTBN 1300 X 13) mit einem etwa 10 molaren Überschuß eines flüssigen DGEBA-Epoxidharzes 3 Stunden lang umgesetzt bis zur Konstanz der Reaktion.

#### Allgemeine Herstellung für das Reaktionsprodukt B)

In einem rühr- und heizbaren Reaktionskessel wurden unter Stickstoffatmosphäre bei 120°C etwa 1,85 Äquivalente des Diisocyanats vorgelegt und anschließend ein Äquivalent des Polyols bei 120°C zugetropft, die Reaktion wurde 3 Stunden bei 120°C fortgeführt. Das entstandene Isocyanat-terminierte Polyurethan-Prepolymer wurde anschließend mit einem stöchiometrischen Überschuß an Polyphenol umgesetzt, wobei das Polyphenol rasch dem Reaktionsgemisch zugegeben wurde. Die Reaktion wurde während einer weiteren Stunde bei 120°C fortgeführt. Anschließend wurde diesem Reaktionsgemisch ein flüssiges Polyesterpolyol zugemischt. Das so erhaltene Gemisch wurde zur Herstellung des Klebstoffes eingesetzt.

#### Allgemeine Herstellung des Klebstoffs

In einem Knetzer wurden bei Raumtemperatur oder ggf. bei 80 °C die Komponenten A), B) sowie ein flüssiges Epoxidharz und ein festes Epoxidharz unter Zugabe der Füllstoffe, Härter, Beschleuniger und Rheologiehilfsmittel bis zur Homogenität gemischt und anschließend ggf. in noch warmem Zustand in die Lagerbehälter abgefüllt.

### Beispiel 1

Gemäß der allgemeinen Herstellung für das Reaktionsprodukt B) wurde aus 66,3 Gewichtsteilen Poly-THF-2000 (Firma BASF), 10,3 Gewichtsteilen Hexamethylendiisocyanat, 8,4 Gewichtsteilen Resorcin und 15,0 Gewichtsteilen Dynacol 7250 (Polyester der Firma Hüls) die Komponente B) hergestellt.

Die Komponente A) wurde nach dem oben angegebenen Verfahren aus Hycar CTBN 1300 X13 und einem flüssigen DGEBA-Harz hergestellt. Es resultierte eine Zusammensetzung mit 40 % Butylkautschuk und einem Epoxyäquivalentgewicht von 900, Viskosität bei 80°C 200 Pa.s.

### Beispiele 2-3

Aus den Komponenten B) gemäß Beispiel 1, der Komponente A) sowie einem flüssigen DGEBA-Harz (Epoxyäquivalentgewicht 189), Füllstoffen, Dicyandiamid als Härter sowie Beschleunigern und hydrophober Kieselsäure als Thixotropiermittel sowie gegebenenfalls dem thermoplastischen Polymerpulver wurden erfindungsgemäße Klebstoffzusammensetzungen hergestellt. Die Zusammensetzungen sind in der Tabelle 1 zusammengefaßt.

Tabelle 1 Erfindungsgemäße Klebstoffe

Beispiel	2	3
Komponente B) aus Beispiel 1	17,5	17,5
Komponente A)	6,5	6,5

DGEBA-Harz flüssig	49,6	49,5
Wollastonit	17,5	14,5
Dicyandiamid	5,5	5,5
Fenuron	0,3	
Imidazol / DGEBA-Addukt		0,5
Polyvinylbutyral		3,0
Kieselsäure, hydrophob	3,0	3,0

Wollastonit Füllstoff

Kieselsäure: Cabosil TS 720 (Cabot)

In der Tabelle 2 sind die klebetechnischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Beispiele und die klebetechnischen Eigenschaften von Klebstoffen gemäß Stand der Technik gegenübergestellt. Bei dem Klebstoff des Vergleichsversuches 1 handelt es sich um Betamate 1044/3 der Firma Gurit Essex. Es wird angenommen, daß dieser Klebstoff auf der Basis der Lehre der EP-A-0 308 664 hergestellt wurde.

Tabelle 2 Klebetechnische Eigenschaften

Beispiel	2	3	Vergleich 1
Impact -40°C [J]	13,1	9,6	3,3
Impact -20°C [J]	16,5	11,5	2,6
Impact 0°C [J]	19,6	13,7	4,4
Impact RT [J]	21,8	14,4	5,2
Impact 50°C [J]	22,7	16,9	5,7
Impact 90°C [J]	21,5	18,2	7,0
ZSF -40°C [Mpa]	40,8	40,4	18,9
ZSF RT [Mpa]	29,5	29,4	16,6
ZSF +90°C [Mpa]	18,3	16,5	13,2
500 h SST	27,8	24,4	15,2
1000 h SST	26,9	23,4	13,3

Impact: Schlagschältest nach ISO 11343 bei 2 m/sec

RT: Raumtemperatur

ZSF: Zugscherfestigkeit nach DIN 53283 auf Stahl 1403 1,5 mm dick

SST: Salzsprühtest nach DIN 50021

kohäsives Bruchbild 100%, wenn nicht anders angegeben

Wie aus diesen Versuchsergebnissen ersichtlich ist, ist die Schlagschälarbeit gemäß ISO 11343 bei den erfindungsgemäßen Klebstoffen um ein Mehrfaches höher als bei den Klebstoffen gemäß Stand der Technik. Insbesondere bei sehr tiefen Temperaturen ist die Schlagschälarbeit der erfindungsgemäßen Klebstoffe deutlich besser als bei denen des Standes der Technik, ohne daß die Zugscherfestigkeit oder das Alterungsverhalten im Salzsprühtest darunter leidet.

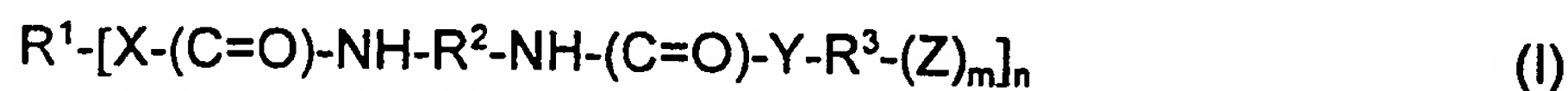


### Patentansprüche

1. Verwendung von Zusammensetzungen, die
  - A) ein Copolymeres mit mindestens einer Glasübergangstemperatur von  $-30^{\circ}\text{C}$  oder niedriger und gegenüber Epoxiden reaktiven Gruppen oder ein Reaktionsprodukt dieses Copolymeren mit einem Polyepoxid sowie
  - B) ein Reaktionsprodukt aus einem Polyurethan-Prepolymer und einem Polyphenol oder Aminophenol sowie
  - C) mindestens ein Epoxidharz enthaltenals Strukturklebstoffe mit guter Tieftemperatur-Schlagfestigkeit.
2. Verwendung der Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Copolymer der Komponente A) ein Copolymeres auf Butadienbasis ist.
3. Verwendung der Zusammensetzungen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Copolymer der Komponente A) ein carboxylgruppenhaltiges Copolymeres auf der Basis von Butadien-Acrylnitril, Butadien-(Meth)acrylsäureestern, ein Butadien-Acrylnitril-Styrol-Copolymeres oder ein Butadien-(meth)acrylat-Styrol-Copolymeres ist.
4. Verwendung der Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Copolymer der Komponente A) ein Kern-Schale-Polymer ist, dessen Kernpolymer ein Dien-Polymer oder ein (Meth)-acrylat-Polymer mit einer Glasübergangstemperatur von  $-30^{\circ}\text{C}$  oder niedriger und das gegebenenfalls mit 0,01 bis 5 Gew.% eines di-olefinischen Comonomers vernetzt sein kann und dessen Schalenpolymer eine Glas-

übergangstemperatur von 60°C oder höher hat und das aus Monomeren aus der Gruppe Alkyl(meth)acrylat, (Meth)acrylnitril, (Methyl)-Styrol und olefinisch ungesättigten Carbonsäuren oder Carbonsäureanhydriden oder deren Mischungen aufgebaut ist.

5. Verwendung der Zusammensetzungen nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente A) ein Addukt aus einem Epoxidharz und einem Copolymer gemäß Anspruch 2 bis 4 eingesetzt wird.
6. Verwendung der Zusammensetzungen nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente B) eine Verbindung gemäß nachfolgender Formel I ist,



wobei

$m = 1$  oder  $2$ ,

$n = 2$  oder  $3$ ,

$R^1$  ein Rest eines Polyalkylenglykols nach dem Entfernen der funktionellen Gruppen (Hydroxyl- oder Amino-Gruppen),

$R^2 = C_6$ - bis  $C_{14}$ -Alkyl, Aryl, Aralkyl (Rest eines Diisocyanates nach Entfernen der Isocyanatgruppen),

$X, Y = -O-$ ,  $-S-$  oder  $-NR^4-$ , wobei  $R^4 = H$  oder  $C_1$ - bis  $C_4$ -Alkyl oder Phenyl,

$R^3 =$  ein carbocyclisch-aromatischer oder araliphatischer  $m + 1$  wertiger Rest mit direkt an den aromatischen Ring gebundenen Gruppen  $Z$  und

Z = -OH oder -NHR<sup>4</sup> (Rest eines Polyphenols oder Aminophenols nach Entfernen der funktionellen Gruppen nach Entfernen der Isocyanatgruppen),  
bedeuten.

7. Verwendung der Zusammensetzung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente B) nach Anspruch 6 in einem flüssigen Polyepoxid gelöst wurde.
8. Verwendung der Zusammensetzung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente B) nach Anspruch 6 mit einem stöchiometrischen Überschuß eines Polyepoxids umgesetzt wurde.
9. Verwendung der Zusammensetzung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich zu den Komponenten A), B) und C)  
D) einen latenten Härter aus der Gruppe Dicyandiamid, Guanamine, Guanidine, Aminoguanidine, feste aromatische Diamine und/oder einen Härtungsbeschleuniger sowie  
E) gegebenenfalls Weichmacher, Reaktivverdünner, Rheologie-Hilfsmittel, Füllstoffe, Netzmittel und/oder Alterungsschutzmittel und/oder Stabilisatoren enthält.
10. Verwendung der Zusammensetzungen nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche als hochfester, schlagfester Strukturklebstoff im Fahrzeugbau, Flugzeugbau oder Schienenfahrzeugbau mit einer Schlagschälarbeit von mindestens 5 J bei -20°C nach ISO 11343.

11. Verwendung der Zusammensetzungen gemäß Anspruch 10 zur Herstellung von Verbundwerkstoffen, als Vergußmassen in der Elektro- bzw. Elektronikindustrie sowie als Die-Attach-Klebstoff bei der Herstellung von Leiterplatten in der Elektronikindustrie.

12. Zusammensetzung zur Verwendung als Klebstoff, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich zu den Komponenten A), B) und C) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche

D) einen latenten Härter aus der Gruppe Dicyandiamid, Guanamine, Guanidine, Aminoguanidine, feste aromatische Diamine und/oder einen Härtungsbeschleuniger,

E) gegebenenfalls Weichmacher, Reaktivverdünner, Rheologie-Hilfsmittel, Füllstoffe, Netzmittel und/oder Alterungsschutzmittel und/oder Stabilisatoren

F) ein Polyesterpolyol mit einem Molekulargewicht zwischen 400 und 5000 sowie

G) gegebenenfalls ein thermoplastisches Polymerpulver enthält.

13. Verfahren zum Härten der Komponenten A), B), C), D), E), gegebenenfalls F) sowie gegebenenfalls G) gemäß Anspruch 12 durch Erwärmen der Zusammensetzung auf Temperaturen zwischen 80 und 210°C, vorzugsweise zwischen 120°C und 180°C.

14. Verfahren zum Verkleben von metallischen und/oder Verbundwerkstoffen gekennzeichnet durch die folgenden wesentlichen Verfahrensschritte

- Aufbringen der Klebstoffzusammensetzung gemäß Anspruch 12 auf mindestens eine der zu fügenden Substratoberflächen gegebenenfalls nach vorheriger Reinigung und/oder Oberflächenbehandlung
- Fügen der Bauteile
- gegebenenfalls Vorgelieren der Klebstoffzusammensetzung
- Aushärten der Verklebung durch Erwärmen der Bauteile auf Temperaturen zwischen 80°C und 210°C, vorzugsweise zwischen 120°C und 180°C.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 99/09732

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 C08L9/00 C08L63/00 C09J163/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 C08L C09J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 308 664 A (CIBA GEIGY AG) 29 March 1989 (1989-03-29) page 1, line 5,24,25,30; claims 5,8 page 12, line 19 ---	1-12
X	EP 0 338 985 A (CIBA GEIGY AG) 25 October 1989 (1989-10-25) page 6, line 54-56; claims 1-17; table 1 ---	1-12
A	EP 0 449 776 A (CIBA GEIGY AG) 2 October 1991 (1991-10-02) -----	1-14

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

**\* Special categories of cited documents :**

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 April 2000

Date of mailing of the international search report

14/04/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3018

Authorized officer

Von Kuzenko, M



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/09732

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0308664 A	29-03-1989	BR 8804345 A	21-03-1989
		CA 1330143 A	07-06-1994
		DE 3864484 A	02-10-1991
		JP 1090233 A	06-04-1989
		JP 2632194 B	23-07-1997
		KR 9701714 B	14-02-1997
		US 5278257 A	11-01-1994
EP 0338985 A	25-10-1989	CA 1334700 A	07-03-1995
		DE 58907670 D	23-06-1994
		JP 2011616 A	16-01-1990
		JP 2724744 B	09-03-1998
		KR 9711633 B	12-07-1997
EP 0449776 A	02-10-1991	AU 638816 B	08-07-1993
		AU 7397091 A	03-10-1991
		CA 2039404 A	01-10-1991
		JP 6049179 A	22-02-1994
		US 5789482 A	04-08-1998
		ZA 9102361 A	24-12-1991

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/09732

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C08L9/00 C08L63/00 C09J163/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C08L C09J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 308 664 A (CIBA GEIGY AG) 29. März 1989 (1989-03-29) Seite 1, Zeile 5,24,25,30; Ansprüche 5,8 Seite 12, Zeile 19	1-12
X	EP 0 338 985 A (CIBA GEIGY AG) 25. Oktober 1989 (1989-10-25) Seite 6, Zeile 54-56; Ansprüche 1-17; Tabelle 1	1-12
A	EP 0 449 776 A (CIBA GEIGY AG) 2. Oktober 1991 (1991-10-02)	1-14

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

4. April 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

14/04/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3018

Bevollmächtigter Bediensteter

Von Kuzenko, M

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/09732

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0308664 A	29-03-1989	BR 8804345 A	21-03-1989
		CA 1330143 A	07-06-1994
		DE 3864484 A	02-10-1991
		JP 1090233 A	06-04-1989
		JP 2632194 B	23-07-1997
		KR 9701714 B	14-02-1997
		US 5278257 A	11-01-1994
EP 0338985 A	25-10-1989	CA 1334700 A	07-03-1995
		DE 58907670 D	23-06-1994
		JP 2011616 A	16-01-1990
		JP 2724744 B	09-03-1998
		KR 9711633 B	12-07-1997
EP 0449776 A	02-10-1991	AU 638816 B	08-07-1993
		AU 7397091 A	03-10-1991
		CA 2039404 A	01-10-1991
		JP 6049179 A	22-02-1994
		US 5789482 A	04-08-1998
		ZA 9102361 A	24-12-1991

### Impact-resistant Epoxide Resin Compositions

This invention relates to the use of mixtures of special diene copolymers and phenol-terminated polyurethanes or polyureas or polyimides in admixture with epoxy resins and/or adducts of epoxy resins with diene copolymers and/or the polyurethane or the polyurea as high-  
5 impact epoxy resin adhesives with particularly good low-temperature properties and to reactive, preferably one-component hotmelt adhesives with good low-temperature impact strength.

Reactive epoxy-based hotmelt adhesives are known. In machine and vehicle construction and especially in the construction of aircraft,  
10 railway vehicles and motor vehicles, components of various metals and/or composite materials are increasingly being joined together with the aid of adhesives. Epoxy adhesives are widely used for high-strength structural bonding, more particularly as heat-curing one-component adhesives which, in many cases, are also formulated as reactive hotmelts. Reactive  
15 hotmelts are adhesives which are solid at room temperature and which soften and behave like a thermoplastic material at temperatures of up to about 80 to 90°C. It is only at relatively high temperatures of about 100°C and higher that the latent hardeners present in these hotmelt adhesives are thermally activated so that irreversible curing to a thermoset occurs. To  
20 join the components together, for example in the vehicle industry, the adhesive is first applied warm to at least one substrate surface, after which the parts to be joined are then fitted together. The adhesive then solidifies on cooling and, through this physical solidification, establishes adequate handling resistance, i.e. a temporary bond. The parts thus joined together  
25 are further treated in various washing, phosphating and dip painting baths. It is only after this that the adhesive is cured at relatively high temperatures in an oven.

Conventional adhesives and hotmelt adhesives based on epoxy resins are hard and brittle in the cured state. Although the bonds obtained with them are generally characterized by very high tensile shear strength, the adhesives flake off under peel, impact or impact/peel stress, particularly at relatively low temperatures, so that loss of bond strength readily occurs when the adhesive joint is subjected to that kind of stress. Accordingly, numerous proposals have already been put forward with a view to so modifying epoxy resins by flexible additives that their brittleness is clearly reduced. One known process is based on the use of special rubber/epoxy resin adducts which are incorporated as heterodisperse phase in the epoxy resin matrix so that the epoxies become more impact-resistant. These epoxy resin compositions are also referred to as "toughened". Another known modification of epoxy resins of the above-mentioned type consists in the reaction of a carboxyl-terminated polybutadiene-co-acrylonitrile copolymer with an epoxy resin. This rubber/epoxy adduct is then dispersed in one or more different epoxy resins. The reaction of the epoxy resin with the carboxyl-containing butadiene/acrylonitrile rubber has to be conducted in such a way that the adduct is not prematurely cured. Although correspondingly modified epoxy resin compositions already represent a clear improvement over unmodified epoxy resins in relation to their impact strength, their behavior under peel or impact/peel stress is still not satisfactory.

**EP-A-0 343 676** describes adhesive compositions made up of a mixture of several epoxy resins, a phenolic resin and a polyurethane/epoxy adduct. The polyurethane/epoxy adduct present therein consists of a reaction product of several polyalkylene glycol homopolymers and copolymers containing primary and secondary OH groups, a diisocyanate and at least one epoxy resin. According to the document in question, these hotmelt adhesive compositions show improved shear resistance, peel strength and impact strength in relation to various commercial one-

component hotmelt adhesive compositions. Unfortunately, there is no reference to the adhesive properties of the cured adhesive joint at low temperatures.

**US-A-5 290 857** describes an epoxy resin adhesive composition  
5 containing an epoxy resin and a powder-form core/shell polymer and a heat-activatable hardener for the epoxy resin. The powder-form core/shell polymer is composed of a core containing an acrylate or methacrylate copolymer with a glass transition temperature of -30°C or lower and a shell containing an acrylate or methacrylate polymer which contains crosslinking  
10 monomer units and which has a glass transition temperature of 70°C or higher, the ratio by weight of the core to the shell being between 10:1 and 1:4. These compositions are said to have excellent adhesive properties, such as peel strength, tensile shear strength and T-peel strength, and also good partial gellability. No mention is made of the properties of bonds with  
15 these adhesives at low temperatures.

Similarly, **US-A-5,686,509** describes an adhesion-strengthening composition for epoxy resins consisting of powder-form copolymer particles ionically crosslinked with a mono- or divalent metal cation. The core of the core/shell polymer is composed of a diene monomer and optionally  
20 crosslinking monomer units and has a glass transition temperature of -30°C or lower. The shell copolymer has a glass transition temperature of at least 70°C and is made up of acrylate or methacrylate monomer units and radically polymerizable unsaturated carboxylic acid units. The adhesive composition is said to contain 15 to 60 parts by weight of the adhesion-  
25 strengthening copolymer powder and 3 to 30 parts by weight of a heat-activatable hardening agent to 100 parts of epoxy resin. These compositions are recommended for use as structural adhesives for automobile parts. No mention is made of the low temperature properties of corresponding bonds.

30 **EP-A-0 308 664** describes epoxy resin compositions which contain

an epoxide adduct of a carboxyl-containing copolymer based on butadiene/acrylonitrile or similar butadiene copolymers and a reaction product of an elastomeric isocyanate-terminated prepolymer soluble or dispersible in epoxy resins with a polyphenol or aminophenol and subsequent reaction of this adduct with an epoxy resin. In addition, these compositions may contain one or more epoxy resins. Furthermore, aminofunctional hardeners, polyaminoamides, polyphenols, polycarboxylic acids and their anhydrides or catalytic hardeners and optionally accelerators are proposed for hardening these compositions. The compositions in question are said to be suitable as adhesives which can have high strength, a high glass transition temperature, high peel strength, high impact strength or high tear propagation resistance according to their particular composition.

EP-A-0 308 664 does not indicate whether the compositions described therein are suitable for adhesives with good low-temperature impact strength.

Similarly, **EP-A-0 353 190** describes epoxy resin compositions containing an adduct of an epoxy resin and a carboxylated butadiene/acrylonitrile copolymer and a reaction product of a hydroxyl-, mercapto- or amino-terminated polyalkylene glycol with a phenol carboxylic acid with subsequent reaction of the phenolic group with an epoxy resin. According to EP-A-0 353 190, these compositions are suitable for the production of adhesives, adhesive films, patches, sealing compounds, paints or matrix resins. There is no indication of whether the adhesives thus produced have good low-temperature impact strength.

According to the teaching of **EP-A-0 354 498** or **EP-A-0 591 307**, reactive hotmelt adhesive compositions can be produced from a resin component, at least one heat-activatable latent hardener for the resin component and optionally accelerators, fillers, thixotropicizing agents and other typical additives, the resin component being obtainable by the



reaction of an epoxy resin solid at room temperature and an epoxy resin liquid at room temperature with one or more linear or branched amino-terminated polyoxypropylenes. The epoxy resins are said to be used in such a quantity, based on the amino-terminated polyoxypropylene, that an  
5 excess of epoxy groups, based on the amino groups, is guaranteed. These adhesive compositions have a high peel resistance in the T-peel test which they retain even at low temperatures.

The problem addressed by the present invention was further to improve reactive adhesives of the type mentioned at the beginning to the  
10 extent that they would have adequate flexibility and increased peel strength not only at room temperature but also - and in particular - at low temperatures (below 0°C). In particular, they would show high peel strength at low temperatures and under impact so that, even in the event of a crash, structurally bonded parts would meet modern safety standards in  
15 vehicle construction. These improvements would be obtained without any deterioration in peel strength at high temperatures or in tensile shear strength. In addition, the reactive adhesives would have to exhibit adequate wash-out resistance immediately after application and before final curing. To that end, the adhesive compositions would have to lend  
20 themselves as hotmelts to formulation as a highly viscous adhesive suitable for warm application. Another possibility would be to formulate the compositions as an adhesive that could be gelled by a thermal preliminary reaction in a so-called "white body oven" or by induction heating of the joined parts.

25 The solution provided by the invention to the problem as stated above is defined in the claims and consists essentially in the use of compositions which contain

- A) a copolymer having at least one glass transition temperature of -30°C or lower and epoxy-reactive groups,
- 30 B) a reaction product of a polyurethane prepolymer and a polyphenol or

aminophenol and

C) at least one epoxy resin,

as structural adhesives with good low-temperature impact strength.

A structural adhesive in the context of the invention is an adhesive  
5 which has a tensile shear strength of 15 MPa at room temperature on steel  
and which still guarantees a tensile shear strength on steel of more than 10  
MPa at an elevated temperature of 90°C. Such an adhesive has good low-  
temperature impact strength when the impact peel energy at 2 m/sec to  
ISO 11343 at -20°C is at least 5 J.

10 Components A), B) and C) may also be mixtures of compounds of  
the type mentioned. Components A) and B) are preferably reacted with a  
large stoichiometric excess of epoxy resins in separate reactions and then  
optionally mixed with other epoxy resins, heat-activatable hardeners and/or  
other additives.

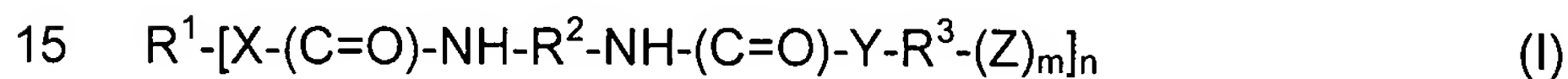
15 Examples of the copolymers of component A) are 1,3-diene  
polymers containing carboxyl groups and other polar ethylenically  
unsaturated comonomers. The diene may be butadiene, isoprene or  
chloroprene and is preferably butadiene. Examples of polar ethylenically  
unsaturated comonomers are acrylic acid, methacrylic acid, lower alkyl  
20 esters of acrylic or methacrylic acid, for example methyl or ethyl esters  
thereof, amides of acrylic or methacrylic acid, fumaric acid, itaconic acid,  
maleic acid or lower alkyl esters or semiesters thereof or maleic acid or  
itaconic anhydride, vinyl esters, such as for example vinyl acetate or - more  
particularly - acrylonitrile or methacrylonitrile. Most particularly preferred  
25 copolymers A) are carboxyl-terminated butadiene/acrylonitrile copolymers  
(CTBN) which are commercially available in liquid form under the name of  
Hycar from B.F. Goodrich. These copolymers have molecular weights of  
2,000 to 5,000 and acrylonitrile contents of 10% to 30%. Actual examples  
are Hycar CTBN 1300 X 8, 1300 X 13 or 1300 X 15.

30 The core/shell polymers known from US-A-5,290,857 and from US-

A-5,686,509 may also be used as component A). The core monomers should have a glass transition temperature of or below  $-30^{\circ}\text{C}$  and may be selected from the group of diene monomers as mentioned above or suitable acrylate or methacrylate monomers. The core polymer may optionally contain crosslinking monomer units in small quantities. The shell is made up of copolymers which have a glass transition temperature of at least  $60^{\circ}\text{C}$ . The shell is preferably made up of lower alkyl acrylate or methacrylate monomer units (methyl or ethyl esters) and polar monomers, such as (meth)acrylonitrile, (meth)acrylamide, styrene or radical-polymerizable unsaturated carboxylic acids or carboxylic anhydrides.

However, the adducts of epoxy resins and the liquid CTBN rubbers mentioned above are particularly preferred for component A).

Component B) may be represented by the following formula I:



in which

$m = 1$  or  $2$ ,

$n = 2$  or  $3$ ,

$\text{R}^1$  is a residue of a polyalkylene glycol after removal of the functional groups (hydroxyl or amino groups),

$\text{R}^2 = \text{C}_{6-14}$  alkyl, aryl, aralkyl (residue of a diisocyanate after removal of the isocyanate groups),

$\text{X, Y} = \text{-O-}, \text{-S-}$  or  $\text{-NR}^4\text{-}$ , where  $\text{R}^4 = \text{H}$  or  $\text{C}_{1-4}$  alkyl or phenyl,

$\text{R}^3$  is a carbocyclic-aromatic or araliphatic  $m+1$ -functional residue with groups  $\text{Z}$  directly attached to the aromatic ring and  $\text{Z} = \text{-OH}$  or  $\text{-NHR}^4$  (residue of a polyphenol or aminophenol after removal of the functional groups).

Component B) is a reaction product of a di- or polyamine or di- or polyol and a diisocyanate. The stoichiometric ratio between amino groups

or hydroxyl groups and isocyanate groups is selected so that the isocyanate groups are present in a stoichiometric excess, preferably of 1.5 to 2, over the amino groups or hydroxyl groups. The isocyanate-terminated polyurethane prepolymer thus formed is then reacted with an excess of polyphenol or aminophenol so that the reaction product bears terminal phenolic or amino groups. Polyester polyols may also be mixed into this reaction mixture. The reaction mixture thus formed is generally reacted directly with the other constituents of the composition, such as component A) and other epoxy resins, although it may also be reacted with a large stoichiometric excess of epoxy resins so that an epoxy-terminated addition product is formed.

In principle, a large number of polyurethane prepolymers may be used for the addition of the poly- or aminophenols although hydroxy-terminated or amino-terminated polyalkylene glycols, more particularly di- or trifunctional hydroxy-terminated or amino-terminated polypropylene glycols, polyethylene glycols or copolymers of propylene glycol and ethylene glycol, and in particular polytetramethylene glycols (poly-THF) are preferably used. Other suitable synthesis components for the polyurethane prepolymers are amino-terminated or hydroxy-terminated polybutadienes. The hydroxy- or amino-terminated polyalkylene glycols and the corresponding polybutadiene derivatives have molecular weights of 400 to 5,000.

In principle, suitable di- or polyisocyanates for the production of the polyurethane prepolymers are any aromatic, aliphatic or cycloaliphatic polyisocyanates known in polyurethane chemistry.

Examples of suitable aromatic polyisocyanates are any isomers of toluene diisocyanate (TDI) either in pure isomer form or in the form of a mixture of several isomers, naphthalene-1,5-diisocyanate, diphenylmethane-4,4'-diisocyanate (MDI), diphenylmethane-2,4'-diisocyanate and mixtures of 4,4'-diphenylmethane diisocyanate with the 2,4' isomer or

mixtures thereof with oligomers of relatively high functionality (so-called crude MDI). Examples of suitable cycloaliphatic polyisocyanates are the hydrogenation products of the above-mentioned aromatic diisocyanates such as, for example, 4,4'-dicyclohexylmethane diisocyanate (H<sub>12</sub>MDI), 1-  
5 isocyanatomethyl-3-isocyanato-1,5,5-trimethyl cyclohexane (isophorone diisocyanate, IPDI), cyclohexane-1,4-diisocyanate, hydrogenated xylylene diisocyanate (H<sub>6</sub>XDI), m- or p-tetramethyl xylylene diisocyanate (m-TMXDI, p-TMXDI) and dimer fatty acid diisocyanate. Examples of aliphatic polyisocyanates are hexane-1,6-diisocyanate (HDI), 1,6-diisocyanato-2,2,4-  
10 trimethyl hexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethyl hexane, butane-1,4-diisocyanate and 1,12-dodecane diisocyanate (C<sub>12</sub>DI). The aliphatic, cycloaliphatic or even araliphatic diisocyanates are particularly preferred.

The polyphenols or aminophenols to be used for reaction product B) are either aromatic di- or trihydroxy compounds derived from a mono- or  
15 polynuclear carbocyclic-aromatic radical or the corresponding aminohydroxy compounds. The aromatic rings may either be condensed or attached to one another by binding links or by a covalent bond.

Examples of the compounds mentioned first are hydroquinone, resorcinol, pyrocatechol, isomers of dihydroxynaphthalene (pure isomers or  
20 a mixture of several isomers), isomers of dihydroxyanthracene and the corresponding aminohydroxy compounds. The polyphenols or aminophenols, which are derived from carbocyclic-aromatic compounds of which the aromatic nuclei are attached by binding links, may be represented by the following general formula II:

25



in which Z is as defined above,

AR is a mononuclear aromatic radical which may optionally be further  
30 substituted by alkyl or alkenyl radicals,

B stands for the binding link which may be selected from the group consisting of a covalent bond,  $-\text{CR}^5\text{R}^6-$ ,  $-\text{O}-$ ,  $-\text{S}-$ ,  $-\text{SO}_2-$ ,  $-\text{CO}-$ ,  $-\text{COO}-$ ,  $-\text{CONR}^7-$  and  $\text{SiR}^8\text{R}^9-$  where  $\text{R}^5$ ,  $\text{R}^6$  and  $\text{R}^7$  independently of one another represent hydrogen,  $-\text{CF}_3$  or  $\text{C}_{1-6}$  alkyl or  $\text{R}^5$  and  $\text{R}^6$  together with the common C atom form a cycloaliphatic radical with 5 to 7 ring C atoms,  $\text{R}^8$  and  $\text{R}^9$  represent  $\text{C}_{1-6}$  alkyl. The two groups B and Z in formula II independently of one another may be located in the ortho, meta or para position. Particularly preferred compounds corresponding to formula II are 4,4'-dihydroxydiphenyl or the bisphenols A and/or F.

10 The polyester polyols optionally present in component B) are the polyester polyols known per se which are used in polyurethane chemistry, for example for the production of hotmelt adhesives.

Examples of such polyester polyols are reaction products of dicarboxylic acids, such as glutaric acid, adipic acid, sebacic acid, suberic acid, 3,3-dimethylglutaric acid, terephthalic acid, isophthalic acid, dimer fatty acid, with low molecular weight dihydric alcohols such as, for example, ethylene glycol, propylene glycol, butane-1,4-diol, diethylene glycol, triethylene glycol or dimer fatty alcohol. Suitable polyester polyols may optionally be lightly branched, i.e. small quantities of a tricarboxylic acid or trihydric alcohol were used for their production.

20 Suitable epoxy resins for component C) or for forming the epoxy adduct or for mixing components A) and B) are any of a number of polyepoxides which contain at least two 1,2-epoxy groups per molecule. The epoxy equivalent of these polyepoxides may be between 150 and 4,000. Basically, the polyepoxides may be saturated, unsaturated, cyclic or acyclic, aliphatic, alicyclic, aromatic or heterocyclic polyepoxide compounds. Examples of suitable polyepoxides include the polyglycidyl ethers which are obtained by reaction of epichlorohydrin or epibromohydrin with a polyphenol in the presence of alkali. Polyphenols suitable for this purpose are, for example, resorcinol, pyrocatechol, hydroquinone,



bisphenol A (bis-(4-hydroxyphenyl)-2,2-propane)), bisphenol F (bis(4-hydroxyphenyl)methane), bis-(4-hydroxyphenyl)1,1-isobutane, 4,4'-dihydroxybenzophenone, bis-(4-hydroxyphenyl)-1,1-ethane, 1,5-hydroxy-naphthalene.

5           Other polyepoxides suitable in principle are the polyglycidyl ethers of polyalcohols or diamines. These polyglycidyl ethers are derived from polyalcohols, such as ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, 1,2-propylene glycol, 1,4-butylene glycol, triethylene glycol, pentane-1,5-diol, hexane-1,6-diol or trimethylol propane.

10           Other polyepoxides are polyglycidyl esters of polycarboxylic acids, for example reaction products of glycidol or epichlorohydrin with aliphatic or aromatic polycarboxylic acids, such as oxalic acid, succinic acid, glutaric acid, terephthalic acid or dimer fatty acid.

          Other epoxides are derived from the epoxidation products of  
15   olefinically unsaturated cycloaliphatic compounds or from native oils and fats.

          The epoxy resins obtained by reaction of bisphenol A or bisphenol F and epichlorohydrin are most particularly preferred. Mixtures of liquid and solid epoxy resins are generally used, the liquid epoxy resins preferably  
20   being based on bisphenol A and having a sufficiently low molecular weight. Epoxy resins liquid at room temperature which generally have an epoxy equivalent weight of 150 to about 220 and more particularly in the range from 182 to 192 are particularly preferred for the adduct formation of components A) and B).

25           The hardness of the reactive adhesive in the cooled state, i.e. in particular after application to the substrate to be joined, but before curing, depends on the degree of condensation and hence molecular weight of component B) in particular and on the ratio of solid epoxy resin to liquid epoxy resin. The higher the degree of condensation (and hence the  
30   molecular weight) of condensation product B) and the greater the



proportion of solid epoxy resin in the composition, the harder the cooled semicrystalline adhesive will be.

Suitable heat-activatable or latent hardeners for the epoxy resin binder system of components A), B) and C) are guanidines, substituted  
5 guanidines, substituted ureas, melamine resins, guanamine derivatives, cyclic tertiary amines, aromatic amines and/or mixtures thereof. The hardeners may be stoichiometrically included in the curing reaction although they may also be catalytically active. Examples of substituted  
10 guanidines are methyl guanidine, dimethyl guanidine, trimethyl guanidine, tetramethyl guanidine, methyl isobiguanidine, dimethyl isobiguanidine, tetramethyl isobiguanidine, hexamethyl isobiguanidine, heptamethyl isobiguanidine and, most particularly, cyanoguanidine (dicyanodiamide). Alkylated benzoguanamine resins, benzoguanamine resins or methoxymethyl ethoxymethyl benzoguanamine are mentioned as  
15 representatives of suitable guanamine derivatives. The selection criterion for the one-component heat-curing hotmelt adhesives is of course their low solubility at room temperature in the resin system so that solid finely ground hardeners are preferred, dicyanodiamide being particularly suitable. The composition is thus guaranteed a long shelf life.

20 Catalytically active substituted ureas may be used in addition to or instead of the hardeners mentioned above. These substituted ureas are, in particular, p-chlorophenyl-N,N-dimethyl urea (Monuron), 3-phenyl-1,1-dimethyl urea (Fenuron) or 3,4-dichlorophenyl-N,N-dimethyl urea (Diuron). In principle, catalytically active tertiary aryl or alkyl amines, for example  
25 benzyl dimethyl amine, tris(dimethylamino)phenol, piperidine or piperidine derivatives, may also be used, but often have too high a solubility in the adhesive system so that the one-component system is not guaranteed useful shelf life in their case. In addition, various, preferably solid imidazole derivatives may be used as catalytically active accelerators. 2-Ethyl-2-  
30 methyl imidazole, N-butyl imidazole, benzimidazole and N-C<sub>1-12</sub>-alkyl

imidazoles or N-arylimidazoles are mentioned as representatives of such accelerators.

In addition, the adhesives according to the invention contain fillers known per se such as, for example, the various ground or precipitated  
5 chalks, carbon black, calcium-magnesium carbonates, heavy spar and, in particular, silicate fillers of the aluminium-magnesium-calcium silicate type, for example wollastonite, chlorite.

The adhesive compositions according to the invention may also contain other typical auxiliaries and additives such as, for example,  
10 plasticizers, reactive diluents, rheology aids, wetting agents, antiagers, stabilizers and/or pigments.

The adhesives according to the invention may be formulated on the one hand as one-component adhesives which in turn may be formulated both as highly viscous adhesives designed for warm application and as  
15 heat-activatable hotmelt adhesives. These adhesives may also be formulated as one-component pregellable adhesives, in which case the compositions contain either fine-particle thermoplastic powders such as, for example, polymethacrylates, polyvinyl butyral or other thermoplastic (co)polymers or the curing system is so adapted that a two-stage curing  
20 process occurs, the gelling step effecting only partial curing of the adhesive and final curing in vehicle construction taking place, for example, in one of the paint ovens, preferably the cathodic electrodeposition oven.

The adhesive compositions according to the invention may also be formulated as two-component epoxy adhesives where the two reaction  
25 components are only mixed just before application, curing then taking place at room temperature or moderately elevated temperature. The second reaction component may be selected from the reaction components known per se for two-component epoxy adhesives, for example di- or polyamines, amino-terminated polyalkylene glycols (for example Jeffamine, Amino-Poly-  
30 THF) or polyaminoamides. Other reactants may be mercaptofunctional

prepolymers such as, for example, the liquid Thiokol polymers. Basically, the epoxy compositions according to the invention may also be cured with carboxylic anhydrides as the second reaction component in two-component adhesive formulations.

5        Besides the applications mentioned at the beginning, the adhesive compositions according to the invention may also be used as potting compounds in the electrical or electronics industries and as die-attach adhesives in electronics for bonding components to circuit boards. Other possible applications for the compositions according to the invention are as  
10       matrix materials for composite materials such as, for example, fiber-reinforced composites.

         However, a most particularly preferred application for the adhesives according to the invention is structural bonding in vehicle construction.

         The quantity ratios between the individual components may vary  
15       within relatively wide limits, depending on the requirements the adhesive is expected to satisfy in regard to its application properties, flexibility, impact peel strength or tensile strength. Typical ranges for the key components are:

- component A) 5-25% by weight, preferably 6-20% by weight
- 20       • component B): 5-30% by weight, preferably 5-20% by weight
- component C): 10-60% by weight, preferably 15-50% by weight; this component may be composed of one or more liquid and/or solid epoxy resins in which case it may optionally contain low molecular weight epoxides as reactive diluents
- 25       • fillers: 10-40% by weight
- hardener component (for heat-curable one-component systems): 1-10% by weight, preferably 3-8% by weight
- accelerator: 0.01-3% by weight, preferably 0.1 to 0.8% by weight
- rheology aid (thixotropicizing agent): 0.5-5% by weight.

30       As mentioned at the beginning, the requirements modern structural

adhesives are expected to meet in vehicle construction continue to increase because more and more structural elements - including those with load-bearing functions - are being joined by bonding processes. As already stated in the article by G. Lötting and S. Singh entitled:

5   **“Anforderungen an Klebstoffe für Strukturverbindungen im Karosseriebau”** Adhesion 1988, No. 9, pages 19 to 26, the adhesives are expected on the one hand to fulfil production aspects of practical relevance, including automatable application in short cycle times, adhesion to oil-covered metal panels, adhesion to various types of metal panels and

10   compatibility with the process conditions on the paint line (resistance to washing and phosphating baths, curability during stoving of the CED primer, resistance to the following painting and drying operations). In addition, modern structural adhesives have to exhibit improving strength and deformation properties, even in the cured state. These include the

15   high corrosion resistance and flexural strength of the structural components and the deformability of the bond under mechanical stress. High deformability of the structural components guarantees a considerable safety advantage in the event of a crash. This crash behavior can best be determined by determining the impact energy for cured bonds; sufficiently

20   high values for impact energy or impact/peel energy are desirable both at high temperatures of up to +90°C and in particular at low temperatures down to -40°C. High tensile shear strength should also be achieved. Both strengths should be achieved on a large number of substrates, mainly oil-covered metal panels, for example steel bodywork panels, steel plate

25   galvanized by various methods, panels of various aluminium alloys or even magnesium alloys and steel plates coated by coil coating with organic coatings of the “Bonazinc” or “Granocoat” type. As shown in the following Examples, the adhesive compositions according to the invention surprisingly satisfy these requirements to a very high degree.

30           The following Examples are intended to illustrate the invention. All

quantities in connection with the compositions are parts by weight, unless otherwise indicated.

General procedure for producing component A)

- 5           A carboxy-terminated poly(butadiene-co-acrylonitrile) (Hycar CTBN 1300 X 13) was reacted for 3 hours with stirring under nitrogen at 140°C with an approximately 10-molar excess of a liquid DGEBA epoxy resin until the reaction was constant.

10   General procedure for preparing reaction product B)

- About 1.85 equivalents of the diisocyanate were introduced under nitrogen at 120°C into a stirred, heatable tank reactor, after which one equivalent of the polyol was added dropwise at 120°C and the reaction was continued for 3 hours at 120°C. The isocyanate-terminated polyurethane  
15   prepolymer formed was then reacted with a stoichiometric excess of polyphenol, the polyphenol being quickly added to the reaction mixture. The reaction was continued for another hour at 120°C, after which a liquid polyester polyol was added to the reaction mixture. The mixture obtained was used for the production of the adhesive.

20

General production of the adhesive

- In a kneader, components A), B) and a liquid epoxy resin and a solid epoxy resin were mixed to homogeneity at room temperature or optionally at 80°C in the presence of the fillers, hardeners, accelerators and rheology  
25   aids and the resulting mixture was poured into the storage containers optionally while still warm.

**Example 1**

- Component B) was prepared from 66.3 parts by weight of Poly-THF-  
30   2000 (a product of BASF), 10.3 parts by weight of hexamethylene

diisocyanate, 8.4 parts by weight of resorcinol and 15.0 parts by weight of Dynacol 7250 (a product of Hüls) by the general procedure for preparing reaction product B).

Component A) was prepared from Hycar CTBN 1300 X13 and a liquid DGBEA resin by the method described above. The resulting composition contained 40% butyl rubber and had an epoxy equivalent weight of 900 and a viscosity at 80°C of 200 Pa.s.

### Examples 2-3

Adhesive compositions according to the invention were prepared from components B) of Example 1, component A) and a liquid DGEBA resin (epoxy equivalent weight 189), fillers, dicyanodiamide as hardener and accelerators and hydrophobic silica as thixotropicizing agent and optionally the thermoplastic polymer powder. The compositions are set out in Table 1.

Table 2. Adhesives according to the invention

Example	2	3
Component B) of Example 1	17.5	17.5
Component A)	6.5	6.5
DGEBA resin, liquid	49.6	49.5
Wollastonite	17.5	14.5
Dicyanodiamide	5.5	5.5
Fenuron	0.3	
Imidazole/DGEBA adduct		0.5
Polyvinyl butyral		3.0
Silica, hydrophobic	3.0	3.0

Wollastonite filler

Silica: Carbosil TS 720 (Cabot)

The adhesive properties of the Examples according to the invention and the adhesive properties of known adhesives are compared in Table 2. The adhesive of Comparison Example 1 was Betamate 1044/3 of Gurit Essex. It is assumed that this adhesive had been produced in accordance with the teaching of EP-A-0 308 664.

Table 2. Adhesive properties

Example	2	3	Comparison 1
Impact -40°C [J]	13.1	9.6	3.3
Impact -20°C [J]	16.5	11.5	2.6
Impact 0°C [J]	19.6	13.7	4.4
Impact RT [J]	21.8	14.4	5.2
Impact 50°C [J]	22.7	16.9	5.7
Impact 90°C	21.5	18.2	7.0
TSS -40°C [Mpa]	40.8	40.4	18.9
TSS RT [Mpa]	29.5	29.4	16.6
TSS +90°C [Mpa]	18.3	16.5	13.2
500 h SST	27.8	24.4	15.2
1000 h SST	26.9	23.4	13.3

Impact: impact peel test to ISO 11343 at 2 m/sec

RT: room temperature

TSS: tensile shear strength to DIN 53283 on 1.5 mm thick 1403 steel

SST: salt spray test to DIN 50021

cohesive fracture pattern 100% unless otherwise indicated

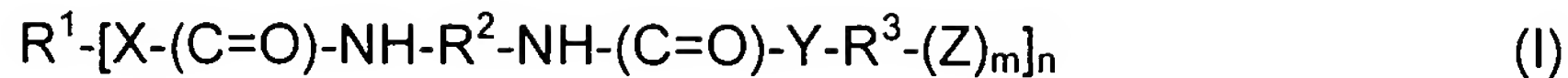
As these test results show, the impact peel energy to ISO 11343 of the adhesives according to the invention is several times higher than that of the known adhesives. At very low temperatures in particular, the impact



peel energy of the adhesives according to the invention is clearly better than that of the known adhesives without any deterioration in tensile shear strength or ageing behavior in the salt spray test.

**CLAIMS**

1. The use of compositions containing
  - A) a copolymer having at least one glass transition temperature of  $-30^{\circ}\text{C}$  or lower and epoxy-reactive groups or a reaction product of this  
5 copolymer with a polyepoxide and
  - B) a reaction product of a polyurethane prepolymer and a polyphenol or aminophenol and
  - C) at least one epoxy resin,as structural adhesives with good low-temperature impact strength.
- 10 2. The use of the compositions claimed in claim 1, characterized in that component A) is a butadiene-based copolymer.
3. The use of the compositions claimed in claim 2, characterized in that the copolymer of component A) is a carboxyl-containing copolymer based on butadiene/acrylonitrile, butadiene/(meth)acrylates, a butadiene/acrylo-  
15 nitrile/styrene copolymer or a butadiene/(meth)acrylate/styrene copolymer.
4. The use of the composition claimed in claim 1, characterized in that the copolymer of component A) is a core/shell polymer of which the core polymer is a diene polymer or a (meth)acrylate polymer with a glass transition temperature of  $-30^{\circ}\text{C}$  or lower and which may optionally be  
20 crosslinked with 0.01 to 5% by weight of a diolefinic comonomer and of which the shell polymer has a glass transition temperature of  $60^{\circ}\text{C}$  or higher and is obtained from monomers from the group consisting of alkyl (meth)acrylate, (meth)acrylonitrile, (methyl) styrene and olefinically unsaturated carboxylic acids or carboxylic anhydrides or mixtures thereof.
- 25 5. The use of the compositions claimed in at least one of the preceding claims, characterized in that an adduct of an epoxy resin and a copolymer according to claims 2 to 4 is used as component A).
6. The use of the compositions claimed in at least one of the preceding claims, characterized in that component B) is a compound corresponding to  
30 formula I:



in which

5     $m = 1$  or  $2$ ,

$n = 2$  or  $3$ ,

$R^1$  is a residue of a polyalkylene glycol after removal of the functional groups (hydroxyl or amino groups),

10     $R^2 = C_{6-14}$  alkyl, aryl, aralkyl (residue of a diisocyanate after removal of the isocyanate groups),

$X, Y = -O-, -S-$  or  $-NR^4-$ , where  $R^4 = H$  or  $C_{1-4}$  alkyl or phenyl,

15     $R^3$  is a carbocyclic-aromatic or araliphatic  $m+1$ -functional residue with groups  $Z$  directly attached to the aromatic ring and  $Z = -OH$  or  $-NHR^4$  (residue of a polyphenol or aminophenol after removal of the functional groups after removal of the isocyanate groups).

7.    The use of the composition claimed in claims 1 to 6, characterized in that component B) according to claim 6 is dissolved in a liquid polyepoxide.

8.    The use of the composition claimed in claims 1 to 5, characterized in that component B) according to claim 6 is reacted with a stoichiometric  
20    excess of a polyepoxide.

9.    The use of the composition claimed in at least one of the preceding claims, characterized in that, in addition to components A), B) and C), it contains

25    D) a latent hardener from the group consisting of dicyanodiamide, guanamines, guanidines, aminoguanidines, solid aromatic diamines and/or a hardening accelerator and

E) optionally plasticizers, reactive diluents, rheology aids, fillers, wetting agents and/or antiagers and/or stabilizers.

30    10.    The use of the compositions claimed in at least one of the preceding claims as a high-strength high-impact structural adhesive with an impact

peel energy of at least 5 J at -20°C (to ISO 11343) in vehicle construction, aircraft construction or rail vehicle construction.

11. The use of the compositions claimed in claim 10 for the production of composite materials, as potting compounds in the electrical and electronics industries and as a die-attach adhesive in the production of circuit boards in the electronics industry.

12. A composition for use as an adhesive, characterized in that, in addition to components A), B) and C) according to any of the preceding claims, it contains

10 D) a latent hardener from the group consisting of dicyanodiamide, guanamines, guanidines, aminoguanidines, solid aromatic diamines and/or a hardening accelerator

E) optionally plasticizers, reactive diluents, rheology aids, fillers, wetting agents and/or antiagers and/or stabilizers

15 F) a polyester polyol with a molecular weight of 400 to 5,000 and

G) optionally a thermoplastic polymer powder.

13. A process for hardening components A), B), C), D), E), optionally F) and optionally G) according to claim 12 by heating the composition to temperatures of 80°C to 210°C and preferably to temperatures of 120°C to 180°C.

14. A process for bonding metallic and/or composite materials comprising the following key process steps:

- applying the adhesive composition claimed in claim 12 to at least one of the substrate surfaces to be joined, optionally after cleaning and/or surface treatment
- fitting together the parts to be joined
- optionally pregelling the adhesive composition and
- curing the bond by heating the parts to temperatures of 80°C to 210°C and preferably to temperatures of 120°C to 180°C.